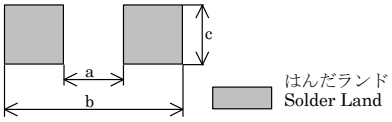
はんだ付け Soldering

推奨ランドパターン
Recommended Land Pattern
■ TSR/TJR, T□T, TCV Type

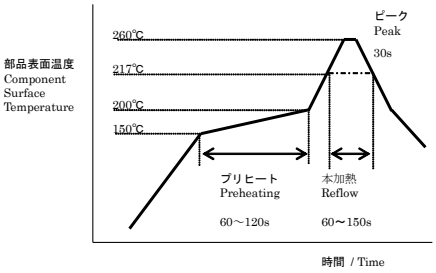


形状 Type	mm サイズ	Inch Size	推奨ランドパターン Recommended Land Pattern (mm)		
			a	b	c
TSR20□	0603	0201	0.26	0.72	0.32
TSR16□, TCV16S, T□T16G	1005	0402	0.50	1.30	0.50
TSR/TJR3□,TCV3S, T□T3G	1608	0603	0.90	2.60	0.70
TSR/TJR6□, T□T6G	2012	0805	1.35	3.45	1.10
TSR/TJR8□, T□T8G	3216	1206	2.20	4.70	1.40
TSR/TJR4□	3225	1210		5.20	2.15
TSR/TJR2□	5025	2010	3.70	6.20	
TSR5□	4532	1812	3.40	5.80	2.75
TSR/TJR1□ (TSR1S)	6332	2512	4.70 (2.0)	7.60 (8.0)	2.75 (3.2)

※ TSM,THC,THE,TSC,TSE 品番については、お問い合わせください。(Please contact us about TSM, THC, THE, TSC, TSE)
※ T□T は、TET,TNT,TCT の略称です。(T□T is the abbreviation of TET, TNT, TCT)

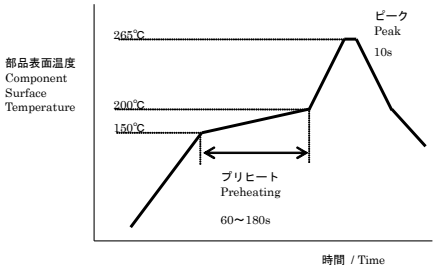
はんだ耐熱条件
Soldering Heat Conditions

リフロープロファイル（３回以内） / Reflow profile (max. 3 cycles)



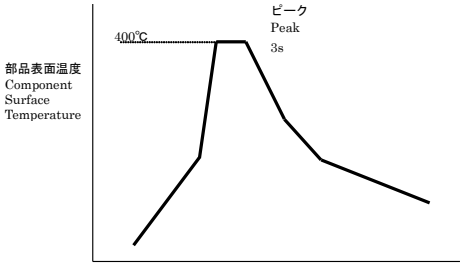
	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
プリヒート / Preheat	150～200℃, 60～120s
本加熱 / Reflow	Min. 217℃, 60～150s
ピーク / Peak	255~260℃,30s 以下

フロープロファイル（３回以内） / Flow profile (max. 3 cycles)



	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
プリヒート / Preheat	150～200℃, 60～180s
ピーク / Peak	Max.265℃, 10s 以下

はんだごて条件（１回以内） / Soldering iron condition (max. 1 cycle)

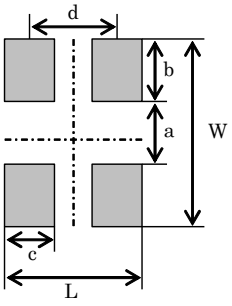


	鉛フリーはんだ / Pb-free solder Sn-3.0Ag-0.5Cu
はんだごて / Soldering iron	Max.400℃, 3s

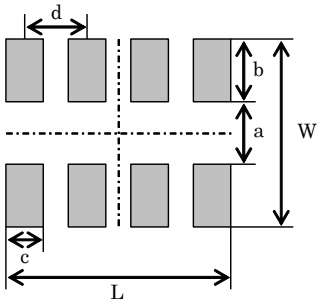
はんだ付け Soldering

推奨ランドパターン
Recommended Land Pattern

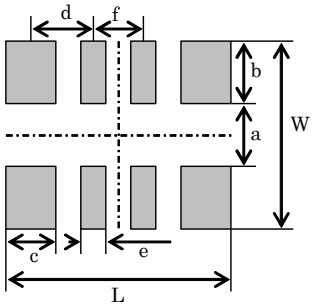
■ TSN Type



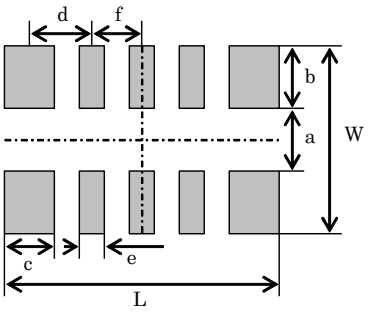
TSN2E, 3E



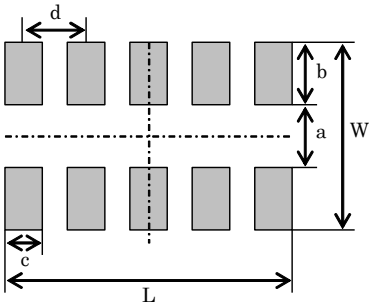
TSN3T, 8T



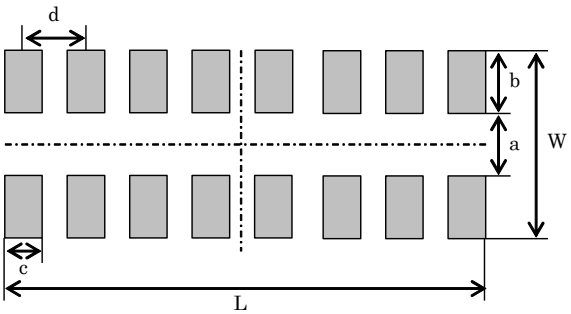
TSN2B, 3B



TSN0□



TSN1□



TSN3A

はんだランド
Solder Land

形状 Type	推奨ランドパターン Recommended Land Pattern (mm)							
	L	W	a	b	c	d	e	f
TSN2E	1.10	1.50	0.50	0.50	0.45	0.65		
TSN2B	2.15					0.60	0.25	0.50
TSN3E	1.30	2.60	0.80	0.90	0.50	0.80		
TSN3T	2.90							
TSN3B	3.25	2.70	1.00	0.85	0.65	0.90	0.45	0.80
TSN0□	3.16	2.40	1.20	0.60	0.45	0.715	0.30	0.64
TSN3A	3.80	2.60	1.00	0.80	0.30	0.50		
TSN8T	4.51	4.20	2.20	1.00	0.70	1.27		
TSN1□	5.78							